**附件1：机电工程学院研究生参加境外国际学术会议资助申请表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 学号 |  | 导师姓名 |  |
| 专业 |  | 年级 | 例：博2023级 | 联系电话 |  |
| 国际学术会议名称 |  |
| 学术会议地点 |  | 时间 | 填写起止时间 |
| 会议拟发表论文作者姓名（全部作者）、论文名称、期刊或论文集名称、发表时间 |  |
| 本人在读期间取得的学术成果 |
| 本人一作或导师一作正式发表的论文： |
| 序号 | 论文题目 | 期刊名称 | 期刊级别（请注明SCI分区、EI期刊、中文核心、CSSCI来源期刊等） | 本人位次 | 是否导师一作 | 第一署名单位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 本人已授权的发明专利： |
| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 本人位次 | 是否导师第一 | 授权年月 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 本人已获得科研奖励： |
| 序号 | 奖励名称 | 奖励类别及等级 | 奖励部门 | 获奖年月 | 本人位次 | 第一完成单位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 导师意见 | □同意 □ 不同意  导师签字： 年 月 日  |
| 学院意见 | □ 通过审批，资助额度 元 □ 不予审批 主管领导签字： 学院盖章 年 月 日 |

注：各类成果须如实填写，超出5项请自行加行。